

证券简称：博敏电子

证券代码：603936

## 博敏电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年9月4日，14:00-15:00
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理徐缓先生、董事兼财务总监刘远程先生、独立董事洪芳女士、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p><b>Q1:请问合肥项目进展如何？</b></p> <p>A1：尊敬的投资者，您好！公司与合肥经济技术开发区管理委员会的合作顺利推进中，2023年6月，公司本次对外投资新设立的全资子公司合肥博睿智芯微电子有限公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照，注册资本5亿元，围绕集成电路设计、制造、销售以及特种陶瓷制品的制造、销售等开展经营业务。目前项目正在筹备可研和环评的相关工作，预计今年Q4开工建设。感谢您的提问！</p> <p><b>Q2:公司预估三季度业绩会怎么样？</b></p> <p>A2：尊敬的投资者，您好！根据相关法律法规的规定，公司不</p>

便预测未来业绩，相关情况请以公司披露的定期报告为准，同时，我们将努力提升经营业绩，不断修炼内功，待行业回暖时可以乘胜追击，感谢您的理解和支持！

**Q3:请问徐董怎么看现在的二级市场公司的股价，定增机构和个人投资者尽数套牢，能不能出台具体方法维护下公司市值，维护下公司在资本市场形象？**

A3: 尊敬的投资者，您好。二级市场股价受宏观环境、资本市场环境、行业估值水平等诸多因素的影响而有所波动，目前公司经营管理正常、战略目标明确，各公司业务拓展顺利。公司保持努力做好经营管理和以较好的业绩回报投资者的初心不变。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。公司在密切关注股价的同时将不断加强与投资者的沟通和关注资本市场的情况，科学有效地传递公司内在价值，提振各方信心，必要时将进行相关的维稳措施。感谢关注。

**Q4:博敏 AMB 产品现在的产能如何，去年说今年 8 月会接到国外客户一张比较大的订单，请问这张订单接到手没有？**

A4: 尊敬的投资者，您好！公司 AMB 陶瓷衬板一期具备产能 8 万张/月，处于国内前列，从去年第四季度开始配合客户需求进行扩产，预计 2023 年有望达到 15-20 万张/月的产能规模。同时在持续拓展新客户并积极参与客户的招投标工作，现阶段进展良好，通过了多家客户的认证且获得订单，预计将于下半年开始生产交付。新开拓的客户包括第三代半导体头部企业、海外车企供应链客户等，前期开拓的客户订单如期交付，我们亦在保供同时持续推进国内外其他标杆客户订单的落地、放量。在 SiC 替代硅基、国产化替代两个大背景下，公司将积极推动陶瓷衬板业务实现快速放量。感谢您的关注！

**Q5:两个月前又有股东在公司股价正处于历史低位时不顾形象**

**恶意减持，徐董对此有什么看法？后续还有没有股东有减持计划？**

A5: 尊敬的投资者，您好。公司高度重视与股东的沟通工作，针对前期股东的减持，公司事前与股东进行了充分沟通，积极向股东传递公司的核心价值和发展理念，但经了解股东减持源自其个人资金需求，且股东的减持亦遵守了相关法律法规的要求。针对当前市场的形势，公司将继续做好与股东的沟通工作，及时传递监管部门号召和相关要求，目前暂未接到股东减持计划，感谢您的关注。

**Q6:领导，您好！我来自四川大决策，请问华为 5G 手机的突围成功，公司是否为接下来的 5G 浪潮机会提前布局？**

A6: 尊敬的投资者，您好！公司再融资项目“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”进一步提升公司在高多层板、HDI 板以及 IC 载板领域的出货占比，优化产品结构，其中可满足 5G 通信等应用领域对 PCB 产品的迭代需求。此外子公司江苏博敏是公司重点培育的面向高端 PCB 市场的智能化生产平台，近日被认定为“国家级专精特新小巨人企业”，多年来专注于 5G 高频高密度集成印制电路细分领域研究，先后攻克了通信终端新一代印制电路产品制造中精细线路制造、微孔制作、高频低损耗线路处理以及无源器件集成等系列关键技术；5G 高频高密度集成印制电路产品在细分领域保有一定份额的市场占有率，并逐步实现国产替代。据 2023 年半年度报告，公司报告期研发费用达到 6,392.20 万元，占营业收入比例为 4.22%，主要投向 5G 通信、大功率新能源、服务器、陶瓷衬板、IC 载板、高阶 MiniLED 等。感谢您的提问！

**Q7:公司股价连续 8 年下跌，董事长有和感触？有什么止跌增信措施？**

A7: 尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受多种因素影响，

与宏观经济环境、大盘走势、市场情绪、市场资金状况等多种因素息息相关，请投资者理性看待股价波动。此外，公司自 2015 年底上市以来坚持每年现金分红，并进行了两次 10 转 4，因此股票价格还需要考虑除息除权。未来公司将立足产业链，坚持既定战略，专注主营业务发展，聚焦价值创造和股东利益最大化，进而回馈广大投资者。感谢您的提问！

**Q8:市场很关心公司成长性问题，请公司告诉一下，增强股民的信心？**

**A8:** 尊敬的投资者，您好！公司实施“PCB+元器件+解决方案”上下游一体化发展战略，将 PCB 业务内核不断向外延拓展（PCB+），打造差异化竞争的护城河，实现收入与盈利能力的双提升，成为最值得信赖的电子电路综合方案提供商。

其中，公司 PCB 事业群战略性聚焦“电源/储能、数据通信、汽车电子、智能终端”四大领域，以“陶瓷基板、特色产品、数连产品”树差异，将 PCB 业务内核持续向高质量、高价值领域延伸，打造持续增长三级火箭，实现产品结构升级及优质客户渗透。顺利推进江苏、梅州、合肥等项目，有序扩产以保证长期增长动能。

解决方案事业群通过整合公司的元器件制造、器件定制化解决方案、PCBA 等相关业务，把器件和解决方案植入现有的 PCB 产品之中，从设计端开始与客户绑定，形成系统化和模块化产品供应能力，实现分立元器件到功能模组、PCBA 方案设计到 EMS（ODM）综合解决方案和产品的提供，为顾客提供满意的产品和服务。同时在保持与 PCB 业务协同、产能扩充和下游同步开发的基础上，持续拓展产业链宽度和深度，重点布局家电、军工、新能源（汽车、电单车、储能）和功率半导体等领域。

公司拥有国际领先的 AMB 工艺技术和生产流程，当前在 SiC 功率半导体产品系列中，公司生产的芯片散热陶瓷衬底已建立起明显领先于行业优势的技术与产能，在 SiC 替代硅基、国

产化替代两个大背景下，公司将 SiC 产业作为达成百亿收入目标的第二增长曲线。感谢您的提问！

**Q9: 公司股价低于增发价，这些机构有无战略眼光？**

A9: 尊敬的投资者，您好！公司股价波动受多种因素影响，但长期来看，股价最终由公司内在价值决定。公司实施“PCB+元器件+解决方案”上下游一体化发展战略，将 PCB 业务内核不断向外延拓展（PCB+），打造差异化竞争的护城河。未来公司将聚焦价值创造和股东利益最大化，进而回馈广大投资者。感谢您的提问！

**Q10: 公司销售收入实现 100 亿估计什么时候？**

A10: 尊敬的投资者，您好！随着公司再融资项目逐步落地投产，以及合肥经开区陶瓷衬板及 IC 封装载板产业基地项目的有序推进，未来公司产值有望进一步提高。具体业绩情况请以公司发布的定期报告为准。感谢您的提问！

**Q11: 公司价值为什么不被市场发现？**

A11: 您好，投资者。资本市场发展是动态的，公司发展和二级市场股价也是动态的，现在并不代表未来，股价短期低迷我能理解您的心情，但我觉得我们更需要用动态的眼光来审视外部环境和公司的可持续发展。公司目前两大事业群共同实施“PCB+元器件+解决方案”上下游一体化发展战略，将业务内核不断向外延拓展（PCB+），打造差异化竞争的护城河，实现收入与盈利能力的双提升，公司是业内少有的拥有上下游一体化解决能力的企业。博敏处于高速发展的过程之中，我们有信心博敏的价值会得到市场的认可。

**Q12: 公司上市以来融资 38.64 亿，分红 1.169 亿，每次定增稀释股份，中小投资者利益受到严重影响。公司有考虑个人投资**

者吗？上市融了那么多钱，分红毛毛雨。股价一路下跌，又考虑中小投资者吗？

A12：尊敬的投资者，您好！公司历次定增均是基于实际情况，立足主业的同时扩大公司发展需要，募投项目产能效益释放也需要时间，并非一蹴而就。PCB 行业具有技术密集和资金密集的特点，公司需要持续的资金、设备投入，以保持并不断提高自身的市场竞争力。

目前公司有多地项目正在开展投资或拟开展投资建设，其中：子公司江苏博敏二期高阶 HDI（SLP, IC 载板）项目（总投资 20 亿元）于 2022 年 8 月投产，目前仍处于产能爬坡阶段，IC 封装载板属于行业前沿技术，具备较高的技术壁垒和资金壁垒；博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（总投资 30 亿元）正在建设阶段；公司与合肥经济技术开发区管理委员会合作的陶瓷衬板及 IC 封装载板产业基地项目总投资 50 亿元，预计将于 2023 年 Q4 开工建设。以上几大项目涉及自有或自筹的投资金额较大，需要大量资金的持续投入以保障项目建设的有序推进。鉴于公司目前正处于成长且有重大资金支出安排的发展阶段，公司在自身经营过程中需密切关注下游应用领域的变化趋势，提前进行技术布局，通过持续资金投入实现效益转换，以不断提高自身在行业中的竞争力。感谢您的理解。

**Q13：公司股价远远落后于同行？公司认为什么原因？**

A13：您好，尊敬的投资者。公司的股价由多重因素决定，包括但不限于公司规模、股本结构、侧重领域以及市场估值等。在同等体量下，同行业友商的股票价格与公司基本趋同，目前公司股价短期承压，我能理解您作为投资者的心情，但我觉得我们更需要用动态的眼光来审视外部环境和公司的可持续发展。未来公司将立足产业链，坚持既定战略，专注主营业务发展，聚焦价值创造和股东利益最大化，进而回馈广大投资者。感谢您的提问！

	<b>Q14: 看公司管理层信心百倍, 期望公司成为中国的“英特尔”?! A14: 期待得到您的继续支持!</b>
<b>日期</b>	2023年9月5日
<b>备注</b>	无